

### **Star\_SM3257ENBA\_N0920**

主要更新:

1. Improve lynn TLC SanDisk 6TCK H2 test yield.
2. Improve A19nm MLC 6DDK Initial and H2 test yield.
3. Improve 19nm MLC 6DCJ Initial and H2 test yield.
4. Improve A19nm MLC 5DCK H2 test yield.

### **Star\_SM3257ENBA\_N0913**

主要更新:

1. Support lynn TLC 7TDK 雙貼低格。
2. Support A19nm MLC 5DCK 1CE 低格。

### **Star\_SM3257ENBA\_N0829\_Formal**

主要更新:

Improve Sandisk 6T2J( 45 DE 98 92 72 57) 2CE UDP Initial and H2test yield.

### **Star\_SM3257ENBA\_N0829\_Multiple CE-Die**

主要更新:

Support 19nmMLC\_6DDJ(1CE/4Die)支援低格&高格。

### **Star\_SM3257ENBA\_N0816\_Formal**

主要更新:

1. Improve HY 16nm MLC 8T2E Initial and H2test yield.
2. Support lynn MLC 7DDK 单颗低格后, 再1Plane+1Plane, 2Plane+2Plane 双贴高格。

### **Star\_SM3257ENBA\_N0816\_Multiple CE-Die**

主要更新:

Support Hy\_20nm\_8T2B(2CE/4CE) 低格开卡。

### **Star\_SM3257ENBA\_N0808**

主要更新:

1. Improve Sandiak 19nm MLC 8K512 Initial and H2test yield.
2. Support Sandisk/Toshiba 19nm TLC 6T2J 2CE LLF.
3. Improve HY 16nm MLC 8D2B Initial and H2test yield.

### **Star\_SM3257ENBA\_N0803**

主要更新:

1. Improve Toshiba lynn MLC 7DDK Initial yield.
2. Improve Sandiak 19nm MLC 8K512 Initial and H2test yield.

### **Star\_SM3257ENBA\_N0726\_Formal**

主要更新:

3. Fix A19nm TLC 6TDK 1CE 低格开卡的一个 Bug。
4. Support A19nm TLC 6TCK / 6TDK 双贴低格。

5. Support HY 16nm MLC H27QDG8D2B(AD 3A 14 AB 42 4A) 。

### Star\_SM3257ENBA\_N0726\_Multiple CE-Die

主要更新:

1. Support Hy\_16nm\_H27UCG8T2E (2CE/2Die)
2. Support Hy\_16nm\_H27UCG8T2D(2CE) (16K、8K)

Notes:这版 Multiple CE-Die F/W 目前还不支持 Hy\_16nm 的 Auto 2plane 功能。

### Star\_SM3257ENBA\_N0719\_Formal

主要更新:

1. Fix 19nm 6TCK 高温测试后, H2 timeout issue。
2. Support 19nm TLC K9AAGD8U0B (EC D5 98 DE 94 C5)。
3. Fix 19nm MLC 6DDJ 高温测试后零字节 issue。

### Star\_SM3257ENBA\_N0719\_Multiple CE-Die

主要更新:

Support A19nm MLC 7DDK双贴低格。

### Star\_SM3257ENBA\_N0712

主要更新:

1. Fix 7T2J 双贴低格半容Issue
2. Support Hynix 16nm 16K 128Page H27UCG8T2DLR Auto 2Plane 及双贴高格
3. Support Hynix 16nm 16K 256Page H27UCG8T2ETR Auto 2Plane 及双贴高格

### Star\_SM3257ENBA\_N0705\_Formal

主要更新:

1. Improve 19nm TLC 7T2J 解 ID 高格双贴 H2 test yield.
2. Support Hynix 16nm 16K 128Page H27UCG8T2DLR.
3. Support Hynix 16nm 16K 256Page H27UCG8T2ETR.
4. Improve Hynix 26nm 8T2B-8K 4GB Initial and H2test yield.

### Star\_SM3257ENBA\_N0705\_Multiple CE-Die

主要更新:

Support 1CE/8Die[45, 3E, 9B, 92, 7E, 57]

### Star\_SM3257ENBA\_N0627

主要更新:

1. Improve 19nm TLC 6T2J Initial and H2test yield.
2. Support Sandisk 1Ynm 128Gb TLC (ID :45 4C A8 92 76 50).
3. Improve HY\_20nm 16K 8T2B (AD DE 94 EB 74 44 )1CE bin leve.
4. Improve A19nm TLC 6TCK (45 DE 98 92 72 50)1CE bin leve.

### Star\_SM3257ENBA\_N0620

主要更新:

1. Improve Intel L84A(89 88 24 4B A9 84 )1CE Initial and H2test yield.
2. Support Hynix 16nm MLC 8T2E (ID : AD DE 14 A7 42 4A).
3. Improve A19nm MLC 6DDK Initial and H2test yield.

#### Star\_SM3257ENBA\_N0614\_Formal

主要更新:

1. Suppor Micron B74A 8GB(2C 88 08 5F 89 00 )1CE (新架构).
2. Support old flash (3D2E/5D2E/4T2E/5T2F/ L63B/L73A/L74A/ B74).
3. Improve 6TCK Initial and H2test yield.
4. Improve 6T2J Initial and H2test yield.
5. Improve L84A(89 88 24 4B A9 84 )1CE Initial and H2test yield.
6. Improve 解 ID 7DDK Initial and H2test yield.

#### Star\_SM3257ENBA\_N0614\_Multiple CE-Die

主要更新: Support Hynix 20nm MLC UCG8T2B 双贴低格

※Support Block mode 双贴和 Page mode 双贴。

※Block mode+Page mode+足容 sample 双贴 PASS (但容量无法到 16G)

※客户若要用两颗 Page mode 双贴时, 请务必选择足容的颗粒。

#### Star\_SM3257ENBA\_N0606\_Formal

主要更新:

Improve 19nm MLC 6DDK Initial, bin level and H2test yield

#### Star\_SM3257ENBA\_N0606\_Multiple CE-Die

主要更新:

Support 24nm MLC 6D2G I-NAND 1CE/8Die LLF & HLF.

#### Star\_SM3257ENBA\_N0531\_Formal

主要更新:

1. 修正 6TCK Sector Mode 高格失败的问题。
2. 更新 19nm 和 19nm 的 POD Mode ISP (修复 Retry Fail 的 bug)。
3. 更新 MPTool, 支援显示 Mark ID 功能, 读 19nm Mark ID 并支持低格&高格。  
注: 显示 Mark ID 功能需要在 Setting.set 中设置[FUNCTION] **EnableTESTID=1.**  
(F/W 中默认为 EnableTESTID=0)

#### Star\_SM3257ENBA\_N0531\_Multiple CE-Die

主要更新:

新增support 64G19eD3 1CE 2Die[45 4C 99 92 76 57]/ 1CE 4Die[45 3C 9A 92 7A 57]

#### Star\_SM3257ENBA\_N0524\_Formal

主要更新:

1. 提升 Sandisk 解 ID 7DDK 开卡和 H2Test 良率。
2. 修正了 Sector Mode 高格失败的问题。
3. 新增支持 21nm TLC ( K9ACGD8U0A) 双 CE 低格 。

4. 解决 MP Tool 不断电测试更换 Flash show 信息 issue。

#### **Star\_SM3257ENBA\_N0524\_Multiple CE-Die**

主要更新:

新增支持Sandisk 24nm 32GB 1CE/4Die

#### **Star\_SM3257ENBA\_N0517**

主要更新:

1. 提升 1ynm TLC(6TCK) Data Retention 良率。
2. 新增支持 24nmMLC(6D2G/6D2H)的 2Plane 的双贴高格。
3. 新增支持 1ynm TLC (7TDK) 低格及双贴高格。
4. 修正 7T2J 双贴高格对比异常的问题。
5. 新增支持 20nmMLC(L84)和 25nmMLC(L74)的低格及双贴高格。
6. 新增支持 K9ADGD8U0M 1xnm TLC 雙貼高格。
7. 新增 5T2F 的 Auto 2P 功能, 提升 H2 速度。
8. 提升 Sandisk 解 ID 7DDK 开卡和 H2 良率。

#### **Star\_SM3257ENBA\_N0510\_Formal**

主要更新:

1. 提升 Sandisk 7DDK H2 良率。
2. 修正 7T2J Byte Mode 越界的问题, 提升整体良率。
3. 新增支持 5DDK 。
4. 新增支持 24nmMLC(6D2G/6D2H)的 2Plane 的双贴高格。

#### **Star\_SM3257ENBA\_N0510\_Multiple CE-Die**

主要更新: Support L74/L84 DDP/QDP/ODP, Support L74/L84 雙貼高格。

#### **Star\_SM3257ENBA\_N0504**

1. 解决K9GCGD8U0C H2 速度慢的问题。
2. 解决Hynix \_20nm\_MLC\_8T2B\_16K 出现有占容和零字节的问题。
3. 解决Hynix \_20nm\_MLC\_8T2B\_16K CB Mode 对比fail 问题。

#### **Star\_SM3257ENBA\_N0425**

1. 提高Sandisk 19nm MLC 7DDK H2Test 良率。
2. 提高Sandisk 5T2J Bin 级。
3. 支持H27UCG8T2ATR 双贴 高格。
4. 更新A19 6TCK&6TDK的ISP, 解决有些Sandisk的flash Clean完后比较容易产生ECC fail问题。
5. 更新MP\_Tool, 解决低格测试开卡PASS 的5T2H(有Info), 大概十多秒就会秀“0X1E”, 再断电后上电可以正常低格PASS 问题。

#### **Star\_SM3257ENBA\_N0419**

Formal release SM3257ENBA F/W N0419. The F/W include three package as bellow,

1. Star\_SM3257ENBA\_N0419\_Formal (General flash supporting)
2. Star\_SM3257ENBA\_N0419\_Multiple CE-Die

此版 Support 以下 Flash:

1. (Support 6D2H、6DDJ 2CE 低格)
2. (Support Sandisk FT fail Sample:24nm&32nm MLC)
3. (Support Sandisk 24nm MLC 1CE4Die)
3. Star\_SM3257ENBA\_N0411\_24nm4CE  
Only support 24nm MLC 6D2G 32GB 45 DE 94 82 76 56 (4CE/4Die) (32768MB)

主要更新:

1. 提升 6D2J bin 级。修正 2 Plane Flash PXS Mode 在特定情况下弹窗的问题。
2. 提升 SA19nm MLC Toggle 开卡及 H2 良率。
3. 更新 MPTool, 支持客户[SM3257ENBA 的低格结果以不同颜色显示]的特殊需求。

如果客户需要, 请在 UFD\_MP\Setting.ini 里设定: CostomerType=9 // F/W 默认=0

### Star\_SM3257ENBA\_N0411

1. 新增 Support 7DDK。
2. 更新[6D2J/6DDJ/6DDK/7DDK/4D2H/5D2H/8K(6D2H/6D2G)/16k-6D2G/16K-8T2B]的 DLL, 修复 PXS Mode 的 bug (P.S: 6DDK/7DDK 没有开 PXS, 不过 DLL 已有更新支持! 如果需要开启只要修改 Script)
3. 提高 L74BT Bin1 比例。
4. 提高 6TCK 良率。
5. 新增 6TDK Mark bad 功能。
6. 更新 ISP, 解决 hynix 8T2B 16k 占容问题。

### Star\_SM3257ENBA\_N0405

主要更新:

1. 提升 6D2G 16K 的 Bin 级及良率。
2. 更新 uDiskToolBar, 解决加密分区问题。
3. 提高 6T2J 开卡 Bin 级及良率。
4. 提高 K9GCGD8U0C 开卡及 H2 良率。

### Star\_SM3257ENBA\_N0323

主要更新:

1. 提升 7T2J 开卡容量及 H2 良率。(Flash ID: 45 4C A8 92 76 57)
2. 增加 19nm/24nm 在 MpTool 显示 ECC Threshold 的功能

更新 MPTOOL.

在 Setting.set 中设置

[FUNCTION]

EnableShowECCThreshold=1

效果如下图:



3. 提升 8T2B 开卡及 H2 良率。

## Star\_SM3257ENBA\_N0315

主要更新:

1. 提升 6T2J 开卡容量及 H2 良率。
2. 提升 6D2G 16K 开卡容量及 H2 良率。
3. 提升 4D2F 开卡容量。
4. 更新 20nm 16K 文件夹,补满 info index page。
5. 解决 Intel L84 开卡 Fail 问题。
6. 更新 MPTool
  - a) 解决防误操作 Function。
  - b) 更新 UFD\_Tool 裡的檔案, 主要修改這些 Tool 支援 Win7 的 support.
7. 19nmMLC,HY\_20nmMLC,HY\_26nmMLC, Info index 补满 data page 修复高格 2Plane bitable 错误 bug。
8. 提升 8T2B Bin 級,H2 良率提升, 解决对比初体失败问题。
9. 支持 6DDJ,6DDK,8T2B 低格后(B+2P+NOB Mode)高格转 SM3267 (SM3267F/W 另行 Release)。

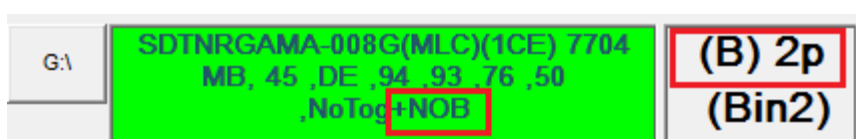
## Star\_SM3257ENBA\_N0310

主要更新:

1. 支持 SM3257ENBA 智能 bad column 低格轉 SM3267AB x1 x2 高格 with 6DDJ and 6DDK  
在 MPTool “其它设定” 里面, 勾选: Enable Smart Bad Column : 5(或者 50)(如下图):



开卡后 MPTool 上会多秀出 “NOB” Mode,如下图:



NOB 目前代表的意思是 Bad Column 砍很少所以不砍 Bad Column, 秀[2Plane 且 Block Mode +NOB]  
这类 flash 可提供转换至 2703 与 3267

2. 更新对 L84,L83,SA19nm MLC,SA21nm MLC,SA27nm MLC,7T2J,6T2H,5T2F, 6TCK\_A19\_4Plane Infor Index 补满
3. 提高 Toshiba/Sandisk 6DDJ(98/45 DE 94 93 76 D7)1CE UDP 开卡良率
4. 提高 Toshiba 4D2F 开卡容量
5. 解决 6DDK (6DDJ)开启智能 BadColumn 设置为 5 时, 部分 Sample 报 0x11 的问题
6. 更新 MPTool,Support 在 Win7 64bit 系统测试
7. Modify F/W to improve performance and test yield with Hynix 20nm MLC UCG8T2A

## Star\_SM3257ENBA\_N0228

主要更新:

1. 新增支持 19nm TLC 低格及双贴高格 (ID : 45,DE,A8,92,76,50)
2. 新增支持 25nm L74
3. 新增 SM3257ENBA+Samsung19nmTLC(K9ADGD8U0M) 双贴高格
4. 解决 FW-N0222-Toshiba 5T2J 高格降容问题
5. 解决 5DCJ,6DCJ,6DDJ,6DDK 估容问题
6. 提高 Sandisk 19nm TLC (45 DE 98 92 72 50) 测试良率
7. 提高 6DDJ,6DCJ Bin 级及良率

## Star\_SM3257ENBA\_N0222

主要更新:

1. 提高 HY 20nm 8K 8T2A 的良率.
2. Support 8K512/7T2J 双贴低格.
3. Support Samsung 21nm MLC K9GCGD8U0A 低格开卡.
4. 修正 5T2J,6T2J 低格开卡的一个 Bug.
5. Support 19nm MLC 6D2J 低格, Auto2p 高格及双贴高格.

## Star\_SM3257ENBA\_N0215

主要更新:

1. 更新了 HY20nm (8T2A/8T2B/8T2C)copy back mode issue
2. 更新 ForceFlash.set, 增加 6D2G 16K
3. 增加支持 4D2H 单贴 1P 低格开卡, 双贴 1P 高格开卡
4. 提高 6DDK 开卡良率
5. 增加 6D2J 单贴 1P 低格开卡支持
6. 提升 Sa 19nm TLC K9ADGD8U0M 开卡量率
7. 提高 L84 开卡良率
8. 增加支持 L83A, ID: 2C,44,44,4B,A9,00
9. 提升 6DCJ 开卡量率
10. 解 TS 19nm MLC Toggle mode 认盘 Issue

## Star\_SM3257ENBA\_N0209

支持目前 SM3257ENBA support 的所有 Flash 混料开卡, F/W 默认设定为:Auto Set ECC.

☑黑片设定

如需改为手动设定 ECC, 请在 Setting.set 中[FUNCTION]

AutoloadFlashECC=0

主要更新:

1. Fix 7T2J 4Plane 开卡 PASS 后, H2 掉盘问题
2. 支持 6D2G 16K Page 单贴 1P 低格开卡支持, 双贴 1P 高格开卡
3. Improve 6DCJ 开卡良率

4. Support Micron M61A: 2C 38 00 26 85 00
5. Fix 6DDJ 8K,512page 分区时秀“格式化失败”的问题
6. 更新 MPTOOL
  - 1. Fix Show 2 Plane for Hynix 20nm 16K on SM3267AB
  - 2. Fix Multi-Lun issue for SM3267AB